

# 创金合信全球芯片产业股票型发起式 证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度 报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026 年 7 月 20 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基金主代码      | 017653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 交易代码       | 017653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 基金合同生效日    | 2023 年 3 月 24 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 报告期末基金份额总额 | 659,100,149.71 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资目标       | 本基金主要精选全球芯片产业相关证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 投资策略       | 1、资产配置策略：本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、国别/地区配置策略：在进行国别/地区配置时，本基金可参考以下因素：（1）基金管理人对相关国家或地区芯片行业投资价值的判断；（2）相关国家或地区政治经济因素，包括政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等；（3）基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。3、全球芯片产业主题的界定：本基金将在全球范围内精选芯片相关产业链中的具备商业竞 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>争力、可持续发展且能够创造更高社会价值、掌握核心技术并积极寻求突破的优质企业；掌握前沿技术的创新企业；以及承载产业转移的新兴市场优秀企业，为投资者带来更长期的回报。本基金所定义的全球芯片产业主题相关行业和公司包括如下两类：（1）芯片的基础研发及制造的相关产业。主要包括芯片的基础研发软件、设计、制造、封测、设备以及材料等相关产业链环节。行业主要涵盖半导体、电子、计算机、通信、电气设备、机械设备、以及化工中的半导体材料等；（2）芯片的拓展应用相关产业。芯片作为高端工业的核心产品，并非直接投向消费市场，而需持续寻找、开发新的应用领域，不断拓展新的发展空间。此类拓展应用相关产业代表着技术应用升级的主要方向。涉及领域主要包括互联网、家用电器中与半导体相关产品或投资半导体相关产业的企业、以及汽车中与自研、生产汽车半导体相关产品或投资半导体相关产业的企业等。同时，本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪，随着公司的不断发展，相关上市公司的范围也会相应改变，本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人，经履行适当程序后，在更新的招募说明书中进行公告。</p> <p>4、权益类品种投资策略：（1）行业配置策略。（2）公司选择策略。（3）组合构建与调整。（4）港股通标的股票投资策略。（5）境内发行的存托凭证投资策略。</p> <p>5、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略。（2）信用债投资策略。（3）可转换债券及可交换债券投资策略。</p> <p>6、基金投资策略。本基金也通过翔实的案头研究和深入的实地调研，结合定量和定性分析，精选出优秀的芯片领域偏股型基金进入组合。</p> <p>7、金融衍生品投资策略。（1）股指期货、股票期权投资策略。（2）国债期货投资策略。紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，研判主要汇率走势，并适度投资外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具，以降低外汇风险。</p> <p>8、其他。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证全球半导体产业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 风险收益特征 | <p>本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。</p> <p>本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 |                               |                       |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 基金管理人           | 创金合信基金管理有限公司                  |                       |
| 基金托管人           | 中国建设银行股份有限公司                  |                       |
| 下属分级基金的基金简称     | 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A         | 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
| 下属分级基金的交易代码     | 017653                        | 017654                |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 97,423,355.08 份               | 561,676,794.63 份      |
| 境外资产托管人         | 英文名称：JPMorgan Chase Bank,N.A. |                       |
|                 | 中文名称：摩根大通银行                   |                       |

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标         | 报告期（2026 年 4 月 1 日—2026 年 6 月 30 日） |                       |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                | 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A               | 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
| 1.本期已实现收益      | 3,176,701.71                        | 21,039,948.90         |
| 2.本期利润         | 55,530,157.44                       | 290,572,269.11        |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 1.0338                              | 1.0246                |
| 4.期末基金资产净值     | 266,521,451.77                      | 1,513,534,389.49      |
| 5.期末基金份额净值     | 2.7357                              | 2.6947                |

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A

| 阶段    | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③     | ②-④    |
|-------|--------|-----------|------------|---------------|---------|--------|
| 过去三个月 | 58.61% | 2.40%     | 73.82%     | 2.47%         | -15.21% | -0.07% |
| 过去六个月 | 52.52% | 2.08%     | 75.33%     | 2.17%         | -22.81% | -0.09% |
| 过去一年  | 98.87% | 1.85%     | 123.32%    | 1.82%         | -24.45  | 0.03%  |

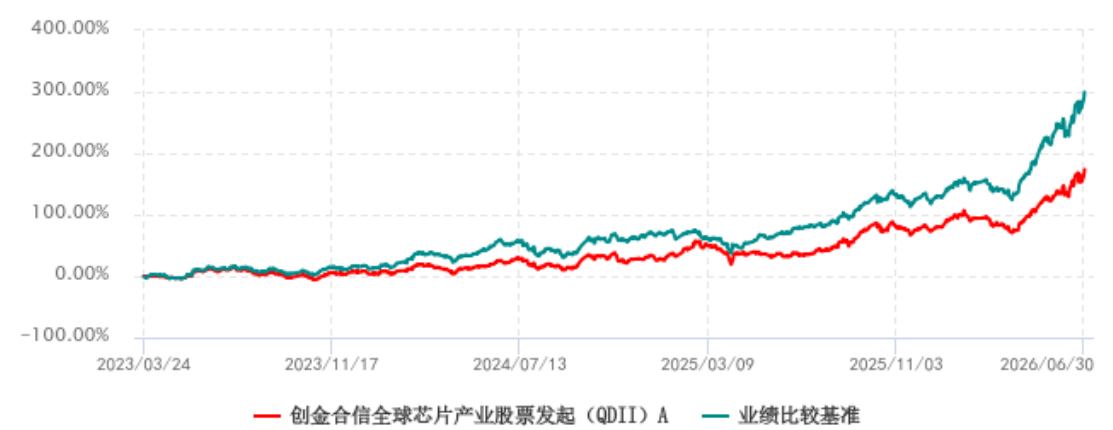
|            |         |       |         |       |          |       |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
|            |         |       |         |       | %        |       |
| 过去三年       | 148.47% | 1.67% | 254.65% | 1.65% | -106.18% | 0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 173.57% | 1.63% | 299.47% | 1.63% | -125.90% | 0.00% |

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C

| 阶段         | 净值增长率①  | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③      | ②-④    |
|------------|---------|---------------|----------------|-----------------------|----------|--------|
| 过去三个月      | 58.11%  | 2.40%         | 73.82%         | 2.47%                 | -15.71%  | -0.07% |
| 过去六个月      | 51.95%  | 2.08%         | 75.33%         | 2.17%                 | -23.38%  | -0.09% |
| 过去一年       | 97.78%  | 1.85%         | 123.32%        | 1.82%                 | -25.54%  | 0.03%  |
| 过去三年       | 145.06% | 1.67%         | 254.65%        | 1.65%                 | -109.59% | 0.02%  |
| 自基金合同生效起至今 | 169.47% | 1.63%         | 299.47%        | 1.63%                 | -130.00% | 0.00%  |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收  
益率变动的比较

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A累计净值增长率与业绩比较基准收益率  
历史走势对比图  
(2023年03月24日–2026年06月30日)



创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率  
历史走势对比图  
(2023年03月24日-2026年06月30日)



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务                    | 任本基金的基金经理期限     |      | 证券从业年限 | 说明                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | 任职日期            | 离任日期 |        |                                                                                                                                                                                                        |
| 赖鹏 | 本基金基金经理               | 2026 年 5 月 26 日 | -    | 11     | 赖鹏先生，中国国籍，香港科技大学硕士研究生，2017 年 9 月加入兴业证券股份有限公司，任研究所研究员，2018 年 11 月加入国盛证券有限责任公司，任研究所研究员，2021 年 5 月加入大家资产管理有限公司责任公司，任研究部研究员，2022 年 9 月加入建信基金管理有限责任公司，任研究部研究员，2024 年 1 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任基金经理。 |
| 刘扬 | 本基金基金经理、风格与行业投资研究部负责人 | 2023 年 3 月 24 日 | -    | 12     | 刘扬先生，中国国籍，中国科学院遥感应用研究所硕士。2014 年 3 月加入长城证券有限责任公司，任金融研究所高级研究员，2015 年 3 月加入前海人寿保险股份有限公司，历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理，2021 年 7 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任风格与行业投资研究部负责人、基金经理。              |

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

## 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

## 4.3 报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

## 4.4 公平交易专项说明

### 4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

### 4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

## 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年二季度，全球资本市场在经历一季度地缘风险冲击后的高波动之后，逐步从“避险去风险”转向“重新拥抱硬科技成长”。以 AI 算力硬件、半导体设备与先进制程为代表的“硬科技”产业链成为全球资本共识，全球硬件属性较强的 SOXX（iShares 费城交易所半导体 ETF）二季度区间涨跌幅达 94.96%；在半导体权重股的带动下，纳斯达克综合指数二季度上涨 21.41%。相比之下，服务业属性的软件互联网在 Agent 商业化节奏分化的背景下表现震荡；A 股方面，在国产替代政策持续催化与半导体景气共振的驱动下，芯片板块显

著跑赢大盘，申万半导体指数二季度区间涨跌幅约 108%，中证半导体指数同期亦上涨约 112%，板块景气与资金情绪形成共振。

分析全球宏观和半导体行业：

（1）全球宏观层面：二季度全球宏观环境仍存在一定不确定性，主要体现在通胀回落路径、美国利率政策节奏以及地缘政治扰动等方面。但与一季度相比，市场对 AI 产业趋势的定价更为明确，成长资产内部出现明显分化。资金更加偏好具备真实业绩增长、全球竞争壁垒和产业链稀缺性的公司。

（2）全球流动性层面：尽管美债利率下行节奏仍存在分歧，但市场对中长期流动性改善的预期并未逆转。对于半导体等高成长行业而言，短期估值波动仍然存在，但只要 AI 资本开支和芯片需求持续兑现，龙头公司的盈利增长有望消化部分估值压力。国内方面，政策托底和流动性环境相对友好，A 股硬科技资产的风险偏好逐步修复。

（3）全球半导体产业层面：

A、AI 算力芯片产业链：随着 AI 模型从训练阶段进一步走向推理和 Agent 应用阶段，算力需求从单一大模型训练扩散至推理集群、企业级应用、端侧 AI 和垂直行业场景。GPU、ASIC、HBM、高速互联、先进封装、光通信等环节成为全球 AI 基础设施建设的核心瓶颈。美股半导体龙头在高端算力芯片、网络芯片、设备和先进制程生态中具备全球定价能力，是全球 AI 产业趋势最直接的受益方向之一。

B、存储与先进封装产业链：AI 服务器对高带宽存储、DDR、企业级 SSD 等需求持续提升，推动存储行业从传统周期属性向 AI 需求驱动的结构成长性阶段切换。与此同时，先进封装已成为后摩尔时代提升芯片性能的重要路径，CoWoS、Chiplet、2.5D/3D 封装等方向景气度持续上行，相关设备、材料和制造环节具备较高产业弹性。

C、A 股半导体国产替代：A 股芯片公司更多代表中国半导体产业链自主可控和国产替代的长期趋势。虽然部分公司短期业绩仍受行业周期、客户验证节奏和资本开支波动影响，但在设备、材料、功率半导体、模拟芯片、先进封装等领域，国产化率提升仍是较为确定的中长期方向。我们更关注其中具备真实订单、技术突破和客户粘性的公司，而非单纯主题性投资机会。

充分研究全球产业趋势和对比不同市场的组成的背景下，本基金在全球半导体资产配置框架发生变化：过去主要投资 A 股、港股、日股、韩国、台股芯片公司，但随着 AI 算力成为全球半导体行业的主导变量，全球芯片产业的定价中心进一步向美股集中。以费城半导体指数为代表的美股芯片公司，覆盖了全球最具代表性的 AI 芯片、设备、存储、网络和先进制程龙头；而 A 股芯片公司则更能代表中国半导体国产替代、供应链安全和本土制造升级的趋势。因此，本基金在报告期内进一步明确投资定位，将组合逐步改造为以美股芯片为主要配置方向、以 A 股芯片为重要补充的全球硬科技组合。我们认为，中美两个市场的芯片公司分别代表了全球半导体产业的两条重要主线：一是全球 AI 算力创新和高端芯

片生态，二是中国半导体自主可控和产业链升级。二者结合，能够更完整地把握全球芯片产业未来的发展方向。

本基金在 2026 年二季度保持较高仓位，以全球半导体和 AI 算力产业链为核心配置方向。报告期内，本基金提高了美股芯片资产的配置比例，重点配置以费城半导体指数成份股为代表的全球半导体龙头；同时保留并优化 A 股芯片配置，重点关注国产替代、半导体设备材料、先进封装及 AI 相关芯片设计公司。组合降低了港股、日股、台股及其他泛科技资产配置比例，既显著提升了组合的研究深度与持仓有效性，使持仓更加聚焦、清晰，又降低了跨市场无效分散带来的跟踪误差。

展望 2026 年三季度，本基金将继续围绕全球半导体产业链进行配置，重点关注 AI 算力芯片、高带宽存储、先进制程、半导体设备、先进封装、光通信以及 A 股国产替代等方向。我们将坚持以产业趋势、盈利兑现和公司竞争壁垒为核心标准，动态调整组合结构，努力在控制波动的基础上提升组合的中长期收益弹性。

由于本基金配置资产以高波动成长类硬科技资产为主，报告期内净值仍可能受到美股科技股波动、汇率、利率预期、地缘风险以及半导体行业阶段性拥挤交易影响。但从中长期看，我们认为全球 AI 算力需求仍处于产业周期早期，半导体作为 AI 基础设施的底层资产，具备较强的长期成长空间。

基于以上判断，本基金在 2026 年三季度将维持较高仓位，继续立足于全球硬科技产业趋势，重点配置以美股芯片为代表的全球半导体龙头，同时精选 A 股芯片产业链中具备国产替代和业绩成长潜力的优质公司，力争为持有人创造长期稳健的超额收益。

截至报告期末创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A 基金份额净值为 2.7357 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 58.61%，同期业绩比较基准收益率为 73.82%；截至本报告期末创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C 基金份额净值为 2.6947 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 58.11%，同期业绩比较基准收益率为 73.82%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。  
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目   | 金额（人民币元）         | 占基金总资产的比例（%） |
|----|------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资 | 1,570,722,289.76 | 85.31        |

|   |                       |                  |        |
|---|-----------------------|------------------|--------|
|   | 其中：普通股                | 1,470,901,611.11 | 79.89  |
|   | 存托凭证                  | 99,820,678.65    | 5.42   |
| 2 | 基金投资                  | 89,054,939.46    | 4.84   |
| 3 | 固定收益投资                | 61,235,006.79    | 3.33   |
|   | 其中：债券                 | 61,235,006.79    | 3.33   |
|   | 资产支持证券                | -                | -      |
| 4 | 金融衍生品投资               | -                | -      |
|   | 其中：远期                 | -                | -      |
|   | 期货                    | -                | -      |
|   | 期权                    | -                | -      |
|   | 权证                    | -                | -      |
| 5 | 买入返售金融资产              | -                | -      |
|   | 其中：买断式回购的<br>买入返售金融资产 | -                | -      |
| 6 | 货币市场工具                | -                | -      |
| 7 | 银行存款和结算备付<br>金合计      | 96,462,499.91    | 5.24   |
| 8 | 其他资产                  | 23,675,431.55    | 1.29   |
| 9 | 合计                    | 1,841,150,167.47 | 100.00 |

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

| 国家（地区） | 公允价值（人民币元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|------------------|--------------|
| 美国     | 1,108,166,148.36 | 62.25        |
| 中国内地   | 456,374,795.36   | 25.64        |
| 中国台湾   | 6,181,346.04     | 0.35         |
| 合计     | 1,570,722,289.76 | 88.24        |

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|------|------------------|--------------|
| 工业   | 76,479,937.12    | 4.30         |
| 公用事业 | 4,376,753.33     | 0.25         |
| 基础材料 | 6,119,010.20     | 0.34         |
| 通讯服务 | 7,092,709.02     | 0.40         |
| 信息技术 | 1,476,653,880.09 | 82.96        |
| 合计   | 1,570,722,289.76 | 88.24        |

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

| 序号 | 公司名 | 公司名 | 证券代 | 所在证 | 所属国 | 数量 | 公允价 | 占基金 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|

|    | 称（英文）                        | 称（中文）                    | 码              | 券市场       | 家（地区） | （股）    | 值（人民币元）       | 资产净值比例（%） |
|----|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------|--------|---------------|-----------|
| 1  | Micron Technology, Inc.      | 美光科技公司                   | MU US Equity   | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 10,882 | 85,551,604.43 | 4.81      |
| 2  | Advanced Micro Devices, Inc. | 超威半导体公司                  | AMD US Equity  | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 14,125 | 55,885,843.86 | 3.14      |
| 3  | Applied Materials, Inc.      | 应用材料公司                   | AMAT US Equity | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 10,300 | 50,720,091.21 | 2.85      |
| 4  | Marvell Technology, Inc.     | Marvell Technology, Inc. | MRVL US Equity | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 23,502 | 47,683,184.32 | 2.68      |
| 5  | Broadcom Inc.                | Broadcom Inc.            | AVGO US Equity | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 17,457 | 44,913,674.66 | 2.52      |
| 6  | Lam Research Corporation     | 拉姆研究公司                   | LRCX US Equity | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 12,565 | 37,083,930.09 | 2.08      |
| 7  | Intel Corporation            | 英特尔公司                    | INTC US Equity | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 35,565 | 33,822,527.22 | 1.90      |
| 8  | Kla Corporation              | 科磊公司                     | KLAC US Equity | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 15,660 | 32,179,994.57 | 1.81      |
| 9  | Asml Holding N.V.            | ASML Holding N.V.        | ASML US Equity | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 2,120  | 28,725,739.02 | 1.61      |
| 10 | Teradyn e, Inc.              | 泰瑞达公司                    | TER US Equity  | 纳斯达克证券交易所 | 美国    | 7,828  | 25,796,280.48 | 1.45      |

### 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

| 债券信用等级 | 公允价值（人民币元）    | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|---------------|--------------|
| 未评级    | 61,235,006.79 | 3.44         |

本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价列示。

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量（张）   | 公允价值（人民币元）    | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|----------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 019827 | 26 国债 01 | 506,000 | 50,927,985.04 | 2.86         |
| 2  | 019792 | 25 国债 19 | 102,000 | 10,307,021.75 | 0.58         |

## 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

## 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

| 序号 | 基金名称                         | 基金类型 | 运作方式   | 管理人                       | 公允价值（人民币元）    | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------------------|------|--------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1  | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF    | ETF  | 交易型开放式 | BlackRock Fund            | 79,850,894.34 | 4.49         |
| 2  | DIREX DAIL SEMI BU 3X ET-USD | ETF  | 交易型开放式 | Direxion Shares ETF Trust | 7,026,357.92  | 0.39         |
| 3  | PROSHARES ULTRAPRO QQQ       | ETF  | 交易型开放式 | ProFund Advisors LLC      | 1,279,904.33  | 0.07         |
| 4  | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1   | ETF  | 交易型开放式 | Invesco Exchange          | 897,782.87    | 0.05         |

## 5.10 投资组合报告附注

**5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形**

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

**5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库**

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

**5.10.3 其他资产构成**

| 序号 | 名称    | 金额（元）         |
|----|-------|---------------|
| 1  | 存出保证金 | 142,488.19    |
| 2  | 应收清算款 | -             |
| 3  | 应收股利  | 168,700.71    |
| 4  | 应收利息  | -             |
| 5  | 应收申购款 | 23,364,242.65 |
| 6  | 其他应收款 | -             |
| 7  | 其他    | -             |
| 8  | 合计    | 23,675,431.55 |

**5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

**5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

**5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分**

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

**§ 6 开放式基金份额变动**

单位：份

| 项目                            | 创金合信全球芯片产业股票<br>发起（QDII）A | 创金合信全球芯片产业股票<br>发起（QDII）C |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 38,871,045.01             | 125,854,602.78            |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 81,491,875.63             | 568,457,640.40            |
| 减：报告期期间基金总赎回<br>份额            | 22,939,565.56             | 132,635,448.55            |
| 报告期期间基金拆分变动份<br>额（份额减少以“-”填列） | -                         | -                         |
| 报告期期末基金份额总额                   | 97,423,355.08             | 561,676,794.63            |

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式 | 交易日期               | 交易份额<br>(份)       | 交易金额<br>(元)       | 适用费率  |
|----|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1  | 赎回   | 2026 年 4 月<br>16 日 | 5,000,450.09      | 9,705,873.62      | 0.00% |
| 2  | 赎回   | 2026 年 4 月<br>16 日 | 5,000,450.00      | 9,588,362.88      | 0.00% |
| 合计 | -    | -                  | 10,000,900.0<br>9 | 19,294,236.5<br>0 | -     |

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目              | 持有份额总数     | 持有份额占<br>基金总份额<br>比例 (%) | 发起份额总数    | 发起份额占<br>基金总份额<br>比例 (%) | 发起份额承<br>诺持有期限 |
|-----------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 基金管理人<br>固有资金   | -          | -                        | -         | -                        | -              |
| 基金管理人<br>高级管理人员 | 20,070.11  | 0.00                     | 20,006.30 | 0.00                     | 36 个月          |
| 基金经理等<br>人员     | 118,586.85 | 0.02                     | 4,997.16  | 0.00                     | 36 个月          |
| 基金管理人<br>股东     | -          | -                        | -         | -                        | -              |
| 其他              | -          | -                        | -         | -                        | -              |
| 合计              | 138,656.96 | 0.02                     | 25,003.46 | 0.00                     | 36 个月          |

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

## § 10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1、《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 2、《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；
- 3、创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)2026 年 2 季度报告原文。

### 10.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

### 10.3 查阅方式

[www.cjhxfund.com](http://www.cjhxfund.com)

创金合信基金管理有限公司

2026 年 7 月 20 日